

國家科學及技術委員會新聞稿附件

第 35 次園區審議會核准投資案

一、凡事可股份有限公司（設立於南部科學園區之高雄園區）

本案投資金額 0.2 億元，研發生產牙科及骨科用之手機、手術動力系統及精密零配件。

公司致力於提升產品之高扭力輸出以縮短手術時間，並採高強度不鏽鋼，可避免傳統產品易產生焊點斷裂、強度不足及疲勞破壞等問題。未來進駐園區後，公司將持續深耕牙科及骨科微創手術動力系統之相關技術研發，以提供高穩定且高效能的產品，將有助於醫材國產化，並有益於南科生技產業之聚落發展。

二、台灣韓松電子材料股份有限公司（設立於南部科學園區之橋頭園區）

本案投資金額 8 億元，主要從事半導體關鍵化學材料之研發與製造。

公司致力於提升臺灣先進半導體材料的本土供應能力，所生產之產品具高純度與高品質等特性，廣泛應用於先進半導體製程及高階電子元件等領域。未來進駐園區後，公司將持續深化在地生產與技術研發，強化臺灣半導體產業鏈關鍵材料供應韌性，提升整體產業國際競爭力。

三、南亞科技股份有限公司屏東分公司（設立於南部科學園區之屏東園區）

本案主要從事先進半導體 3D 晶圓封裝及測試業務，公司以矽穿孔與晶圓堆疊技術，開發高容量、高頻寬、低延遲、低功耗之記憶體模組，並透過深化客戶合作與確保供應鏈彈性，持續推動技術創新，穩固產品獨特性與市場領先地位。未來進駐園區後，公司將持續深化在地生產與技術研發，提升國內高效能記憶體產品之自主研發與製造專業能力，並帶動南部半導體產業聚落及人才培育。

四、鈞匠科技實業股份有限公司（設立於中部科學園區之臺中園區）

本案投資金額 0.3 億元，主要產品為 AI 創能建築平台，包含鈣鈦礦創能窗等創能建材、奈米陶瓷光濾節能建材，以及 SpaceCode 建築資訊整合系統。

本案公司以高性能鋁門窗設計研發起家，結合高效能鈣鈦礦太陽能電池，將傳統窗戶升級為兼具透光、創能、隔音與美學之 BIPV 建材，應用於建築立面、玻璃帷幕及欄杆，使建築由耗能體轉為「垂直電廠」。節能建材採無機奈米陶瓷光濾技術，紅外線阻隔率逾 90%、紫外線逾 99%，經客戶驗證室內外溫差達 3 至 5 度，並取得內政部高性能節能綠建材標章。另運用 AI 與 BIM 建置 SpaceCode 平台，導入 AI Agent 及 MCP 協定，提供建材報價、施工管理及供應鏈整合。未來進駐中科，將串聯「鈣鈦礦電池供應→創能建材整合→綠建築應用」產業鏈，對接綠建築政策與全球淨零趨勢，推動建築綠能轉型。

五、京和科技股份有限公司中科分公司（設立於中部科學園區之二林園區）

本案投資金額 9.5 億元，提供無水氯化氫（AHCl）與電子級氯氣（Cl₂）等關鍵特殊氣體，作為晶圓乾式蝕刻、選擇性磊晶成長及腔體清潔等核心工序之基質，並搭配即時補給與技術支援，協助客戶強化供應鏈彈性。

為深耕並緊密支援中部科學園區先進晶圓廠之需求，本案公司積極推動中科分公司進駐計畫。本案結合成熟之純化技術，將既有特氣優勢延伸至 AHCl 及 Cl₂ 領域，藉此掌握產品品質與交期自主權，並縮短供應鏈反應時間，同時有效降低國際運輸與外部供應風險，進一步鞏固臺灣半導體關鍵材料之自主供應能力與產業韌性。

六、芯曜半導體股份有限公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額約 5.21 億元，主要產品為碳化矽（SiC）晶錠及基板材料。

本案公司專注於 SiC 單晶長晶，採物理氣相傳輸法（PVT）發展大尺寸、低缺陷之 4H-SiC 材料，初期以 8 吋為主，並同步推進 12 吋技術驗證。產品涵蓋導電型、熱管理型、高阻型及光學型四大材料，可應用於功率元件、人工智慧資料中心散熱、高頻通訊及光學元件等領域。

預計本案公司進駐園區後，將運用園區半導體產業聚落及供應鏈資源優勢，加速設備導入、製程開發與客戶驗證，並逐步培育材料及製程人才，有助補強我國化合物半導體上游材料供應能力，提升關鍵材料自主性及供應鏈韌性。

七、寶碩智匯科技股份有限公司（設立於新竹科學園區之新竹園區）

本案投資金額 2 億元，主要產品為數位孿生（Omniverse Digital Twin）應

用服務，旨在透過 2D CAD 圖面與先進實體 AI 演算法整合技術，為 IC 製造及封裝測試產業提供秒級生成「高精度模擬」與「預測性決策」方案，核心技術將應用於解決高階晶片封裝所需之材料精準度與熱管理挑戰。

本案公司為上市公司南寶樹脂所投資之新創 AI 公司，研發團隊將打造融合 Nvidia Ready Open USD 的新平台，百分之百符合物理定律的模擬、萬倍速 AI 與機器人訓練，可實現預測性維護與節能，並協助新建廠房減少設計變更、縮短建廠工時，使臺灣 IC 製造與封裝測試廠廠商可提早量產，大幅提升產業競爭力。

八、豐譽智慧動能股份有限公司（設立於新竹科學園區之宜蘭園區）

本案投資金額 0.25 億元，主要產品為「智慧工地系統」，包含環境監測及冷熱危害警示系統、AI 電梯井墜落預防輔助系統、人臉辨識門禁系統、臨時電箱監視系統、移動式電子圍籬及監視系統、垃圾管道智能監視警示系統及智慧工地系統平台等。

本案公司專注於智慧科技應用，開發全方位的「智慧工地系統」，整合 AI 影像辨識、LoRa 射頻模組、自動化聯動安全管理等核心技術，經由感測器或影像收集資訊，可即時現場輸出控制並傳輸至雲端提供管理人員資訊及接收警報，系統功能涵蓋即時監控、預警功能、風險告知、智能管控、數據記錄等。透過將智慧科技應用於高風險作業環境，可提供全方位工地解決方案，以「智慧減災」方式強化作業環境安全，降低職災發生率，有助於推動營建產業數位轉型，提升臺灣智慧工地技術創新能量與國際競爭力。

九、廣運航太股份有限公司（設立於新竹科學園區之宜蘭園區）

本案投資金額 0.88 億元，主要從事航太、無人機、AI 智慧製造及低空經濟相關技術之研發與製造。本案公司計畫於第一年一次挹注資金，作為建廠、設備進駐及研發啟動之基礎，並於未來三年持續投入智慧工廠建置、技術升級與人才培育，強化國際供應鏈競爭力。

本案公司預計於第一年度完成航太級智慧製造基礎建構，第二年度推動智慧製造與 OEM/ODM 整合服務，第三年度建立無人機產業技術平台，協助臺灣無人機國家隊與國際接軌。本投資案預期將促進宜蘭園區產業聚落發展，帶動地方高階製造與研發能量提升。